

各 位

2002年4月5日
日本特殊陶業株式会社
IBMコーポレーション

日本特殊陶業とIBM、クロス・ライセンス契約を締結

日本特殊陶業株式会社（本社：名古屋市、社長兼CEO:金川重信）とIBMコーポレーション（本社：米国ニューヨーク州アーモンク、社長兼CEO:サミュエル・J・パルミサーノ）は、このたびセラミックおよび有機半導体パッケージング技術に関するクロス・ライセンス契約を締結しました。

今回の合意により、日本特殊陶業とIBMは、チップを熱やその他の機械的な側面から保護するためチップを覆ったり、チップとチップが組み込まれている電子機器全体に接続するといった両社の半導体パッケージング関連特許を、お互いに使用することができるようになります。チップがより複雑化するのに伴い、チップの動作速度と性能のあらゆる可能性の実現を確実なものとしていくために、先端パッケージング技術、特にインターコネクト技術の重要性が増してきています。

IBMの先端パッケージング技術は、業界において一部の高密度電子部品の製造に活用されています。インターコネクト製品およびサービスのサプライヤーとして業界有数の企業であるIBMは、パッケージされた半導体から完全にテストされたエレクトロニック・アセンブリーまでアプリケーション全般を支援します。日本特殊陶業は現在、IBMに対して精選されたチップ・パッケージング製品を製造しています。

日本特殊陶業の副社長兼COO、羽賀征治は、「今回の合意により、IBMと日本特殊陶業にとって技術開発面でもより一層の成果をもたらすことができるとともに、次世代パッケージング技術をより早く、適時に開発することができることを確信しています。」と語っています。

IBMマイクロエレクトロニクス部門、インターコネクト製品バイス・プレジデント トム・コールフィールドは、「IBMは日本特殊陶業より素晴らしいサポートを受けており、今回の合意はその関係を強化するものです。このたびの合意は、主に新しいパッケージング技術を提供し、IBMの半導体を活用されるお客様向けにオプションを提供するもので、両社にとって意義のあるものです。」と述べています。

以上

（注記）上記文面は、4月5日米国東部時間に発表されたりリースの翻訳です。
IBMは、IBM Corporationの商標です。

（お問い合わせ先）

日本特殊陶業株式会社	取締役総務部長	橋本 玄次郎	Tel: 052-872-5915
日本IBM株式会社	広報	沼 啓介	Tel: 046-215-5430